

惠丰钻石股份有限公司

改变募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

2022年7月18日，惠丰钻石股份有限公司（简称“惠丰钻石”“公司”）发行普通股1,100万股，发行方式为公开发行，发行价格为28.18元/股，募集资金总额为309,980,000元，实际募集资金净额为285,386,886.79元，到账时间为2022年7月4日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为4,364.58万元，到账时间为2022年8月17日。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至2025年11月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划 投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额 （2）	投入进度 （%） （3）=（2） /（1）
1	金刚石微粉智能生产基地扩建项目	惠丰钻石股份有限公司	149,000,000.00	0.00	0.00%
2	研发中心	河南省惠丰	73,000,000.00	70,627,222.38	96.75%

	升级建设项目	金刚石有限公司			
3	补充流动资金	惠丰钻石股份有限公司	107,032,655.67	107,032,655.67	100.00%
合计	-	-	329,032,655.67	177,659,878.05	53.99%

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	专户账号	金额（元）
1	中国银行股份有限公司柘城支行	263781660143	1,108,218.31
2	华夏银行郑州北环路支行	15556000001002177	2,664,642.85
合计	-	-	3,772,861.16

注 1：上表金额包括专户利息收入；

注 2：上表余额未包括理财产品账户余额，截至 2025 年 11 月 30 日，公司购买理财产品余额为 5,500.00 万元；

注 3：上表余额未包括暂时补充流动资产金额 10,000.00 万元；

注 4：华夏银行募集资金专户 15556000001002177 包含其子账户 15556000001054705 余额，子账户不具备对外结算功能，并且该子账户已注销。

二、改变募集资金用途的具体情况

（一）改变募集资金用途的概况

单位：元

序号	原定募集资金用途	改变前拟投资金额	改变后募集资金用途	改变后拟投资金额	募集资金用途改变的主要原因（请简要描述）
1	金刚石微粉智能生产	149,000,000.00	惠丰钻石数智科技年产 20 亿克拉高性能	156,108,218.31	见下文“（二）改变募集资

	基地扩 建项目		金刚石粉体项 目		金用途的 原因”
合 计	-	149,000,000.00	-	156,108,218.31	-

注：“改变后拟投资金额”大于“改变前拟投资金额”主要系变更后金额中含有募集资金的利息，最终变更金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。

（二）改变募集资金用途的原因

2021年至2022年1月，随着市场需求激增，公司产能短缺，公司规划了募投项目“金刚石微粉智能生产基地扩建项目”，计划扩大金刚石微粉、金刚石破碎整形料的生产规模。由于上市过程中政府提供厂房土地租给公司使用，公司在此基础上以自有资金提前完成扩产建设。

2022年7月公司上市募集资金到位后，因募投项目的实施方式、实施地点与上述实际投入情况存在较大差异，公司未进行募集资金置换。且通过前一阶段扩产，公司金刚石微粉产能暂时可以满足当时的市场需求，故暂缓实施了该项目。

2023年以来，公司多次组织高管及行业专家等对拟投资方向进行充分讨论，并组织专门人员与地方政府进行接洽，商讨项目计划。经过多方考察，公司了解到目前金刚石微粉行情处于“低端承压、高端向好”的特征，即应用于建筑与建材领域等领域的低端微粉需求不足，而应用于新能源汽车、纳米金刚石医药载体、消费电子、航空航天和国防军工等领域的微粉需求仍然旺盛且潜力巨大。鉴于此，公司拟对“金刚石微粉智能生产基地扩建项目”进行变更，取消项目中的金刚石破碎整形料和低性能金刚石微粉，增加高性能金刚石微粉的产能，并配置若干台大缸径六面顶压机。调整后一方面能解决生产高性能金刚石微粉所需的部分原材料金刚石单晶，减少原材料价格波动对公司毛利率的影响，增加金刚石单晶生产环节的利润，提升公司盈利水平；另一方面，新项目拟采用数智科技生产方式，生产过程实现数字化和自动化，提高公司金刚石微粉生产技术和工艺水平，促进公司向精细化、专用化、功能化方向发展，叠加项目所获取的优惠政策，能够降低公司金刚石微粉生产成本；此外，随着5G通信、新能源电动汽车及航空航天技术等领域的迅猛发展，芯片级和模块级电子设备向着微型化、多功能化、高功率密度方向发展，极大地增加了电子设备的热量积累，散热问题已成为制约电子

技术进步的瓶颈，高导热金刚石金属复合材料具有非常广泛的应用前景。公司研发生产的高导热金刚石金属复合材料需要使用金刚石单晶和高性能金刚石微粉，项目实施后能打通金刚石单晶-高性能金刚石微粉-金刚石金属复合散热材料整个产业链，掌握金刚石金属复合散热材料应用的关键技术和关键原材料，同时能从源头方面降低金刚石金属复合散热材料的成本，为金刚石金属复合散热技术的大规模产业化扫清了重要的成本障碍；再者，高性能金刚石微粉在电极材料、耐磨材料、光电器件和生物医药材料等方向也具备可观的发展潜力。因此，公司决定将原“金刚石微粉智能生产基地扩建项目”变更为“惠丰钻石数智科技年产20亿克拉高性能金刚石粉体项目”。

（三）改变后的募集资金用途具体情况

1、项目基本情况

- （1）项目名称：惠丰钻石数智科技年产20亿克拉高性能金刚石粉体项目
- （2）建设地点：商丘市柘城县高新区东区
- （3）建设单位：惠丰钻石股份有限公司
- （4）项目总投资额：50,506.90万元
- （5）项目建设期限：2年

2、项目投资及募集资金拟投入计划

本项目总投资额50,506.90万元，其中使用募集资金15,610.82万元，剩余资金由公司自有资金或自筹资金补足。资金具体使用计划如下：

单位：万元

序号	项目	金额	占比
1	工程费用	41,459.71	82.09%
1.1	建筑工程费	16,803.84	33.27%
1.2	设备购置费	23,660.50	46.85%
1.3	安装工程费	995.37	1.97%
2	工程建设其他费用	5,804.82	11.49%
3	预备费	2,214.72	4.39%
4	建设期利息	1,027.65	2.03%

合计	50,506.90	100.00%
----	-----------	---------

（四）改变后的募集资金用途可行性分析

1、扶持政策密集出台，为项目实施提供良好的外部环境

我国政府高度重视新材料、超硬材料产业的健康发展，近年来出台一系列相关政策，旨在推动产业生态建设，引导模式和技术创新。作为新材料和超硬材料产业的重要细分领域，人造金刚石行业的发展自然也受到产业政策的积极扶持。中央和地方级扶持政策的密集出台，为项目实施提供良好的外部政策环境。

本项目是国家产业结构调整中鼓励和支持的行业，项目产品属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》鼓励类产业“十二、建材：10. 高品质人工晶体材料、多功能透明件、特种光学玻璃材料、制品和器件，功能性人造金刚石材料生产装备技术开发；四十九、数控机床：5. 高端数控机床用关键部件、附件及工量具：硬质合金、超硬材料等切削刀具及工具系统，高性能磨料磨具（金刚石、CBN 等超硬材料及其微粉，特殊材料磨削用砂轮）。”

《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》，战略新兴产业中第三条中指出新材料产业包括“高纯元素及化合物高功率石墨电极，锂离子电池负极用石墨，中间相碳微球，人造金刚石等”。

《战略性新兴产业分类（2018）》将“人造金刚石”列入“战略性新兴产业分类”中的“先进无机非金属材料”，将“金刚石与金属复合材料”、“金刚石与金属复合制品”列入“战略性新兴产业分类”中的“高性能纤维复合材料和制品”，属于国家重点发展的新材料。

2025 年 10 月 16 日，工业和信息化部发布《建材工业鼓励推广应用的技术和产品目录（2025 年本）》，高导热金刚石金属复合材料被列入“高端化”的技术和产品。

本项目实施能够提高公司微粉生产技术和工艺水平，以更好地满足新兴高科技行业对高性能金刚石微粉的需求。因此项目实施符合国家政策要求和行业发展趋势，具有较强的可行性。

2、高性能金刚石粉体需求旺盛，市场空间广阔

当前，全球光伏、IT 加工、线切工具制造等产业加速向中国集中，晶硅片、LED 照明设备、电子产品、高档屏幕及防护屏、军工设备显示屏等产品的加工环节，对高效、精密、低成本的新型金刚石线切工具需求旺盛，为金刚石粉体开辟了广阔市场空间。高性能金刚石粉体不仅广泛应用于光伏、消费电子、LED 蓝宝石、磁性材料、陶瓷材料等传统及新兴领域，覆盖 3C 产品、LED 半导体照明、新能源汽车等核心产业，其在光、电、声、热等领域的功能性应用也初露端倪，产业化进程即将全面开启，其中金刚石导热复合材料凭借超高导热性能，通过与金属、陶瓷、聚合物等基体复合，已在高端服务器 CPU 散热基板、新能源汽车动力电池包散热片、消费电子芯片散热膜等场景实现应用，未来在高热流密度器件散热领域将形成巨大市场需求；在电极材料、耐磨材料、光电器件和生物医药材料等方向也具备可观的发展潜力。

3、本项目的实施能够延长产业链，优化产品结构，提升公司竞争实力

公司目前生产金刚石粉体所需的原材料金刚石单晶系外购，高强度工业金刚石供应厂家较少，本项目的实施补齐了粉体上游原材料来源短板，将产业链延伸至上游原材料环节，减少原材料价格波动对公司毛利率的影响，增加金刚石单晶生产环节的利润。同时，本项目重点布局金刚石散热、半导体、新能源汽车、生物医药、光电器件等应用领域，随着项目的开展增加高附加值领域产品的生产和销售，将显著提升公司的综合实力。

4、公司专业队伍和丰富的技术储备为项目实施提供了有利条件

公司是一家专注于金刚石微粉、金刚石破碎整形料及 CVD 培育钻石等产品研发、生产和销售工作的国家级高新技术企业，同时，公司还是中国机床工具工业协会超硬材料分会副理事长单位、在编国家标准“超硬材料人造金刚石微粉”起草单位之一，是金刚石微纳粉体河南省工程实验室、河南省亚微米超硬材料粉体工程技术研究中心、河南省企业技术中心建设依托单位、设立了河南省微纳米金刚石粉体材料院士工作站及河南省博士后研发基地，是行业技术研发的骨干力量。公司主要产品为金刚石微粉和金刚石破碎整形料、CVD 培育钻石三大类型，其中金刚石微粉为公司主打产品。公司的技术水平和产品竞争力，在细分行业处于国内领先地位，是行业技术研发的骨干力量和金刚石微粉生产龙头企业。公司自成立以来即高度重视核心队伍的培养与储备，除了自身培养外，公司还吸引了

一批优秀的金刚石行业人才加入，在人力资源储备方面具备一定竞争优势。

综上，为提高公司微粉生产技术和工艺水平，优化公司产品结构，提升公司竞争实力，公司拟投资“惠丰钻石数智科技年产 20 亿克拉高性能金刚石粉体项目”。

三、决策程序

（一）审议程序

2025 年 12 月 31 日，公司召开第四届董事会 2025 年第三次战略委员会、第四届董事会 2025 年第三次审计委员会、独立董事专门会议 2025 年第五次会议和第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）本次改变募集资金用途存在需经有关部门批准的情况

公司已完成项目备案（项目代码：2505-411424-04-02-301453）、环评手续（商环审〔2025〕42 号），正在办理项目用地手续，尚需办理项目安评、建设规划许可和施工许可等审批程序。

四、本次改变募集资金用途对公司的影响

（一）具体情况

公司本次变更募集资金用途，是公司根据项目实际情况、公司中长期发展规划及市场需求情况而作出的审慎决定。本次变更未改变募集资金涉及的业务领域和方向，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司募集资金使用计划，有利于公司长远发展。

（二）是否损害上市公司利益

公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

五、专项意见说明

（一）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次改变募集资金用途的事项，已经公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会 2025 年第三次战略委员会、第四届董事会 2025 年第三次审计委员会、独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过，尚需公司 2026 年第一次临时股东会审议，公司本次交易事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规和《公司章程》的要求。本次变更募集资金用途符合公司主营业务发展方向，有利于公司长远发展，相关事项符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次变更募集资金用途的事项无异议。

（二）审计委员会意见

经审阅，我们认为公司本次变更募集资金用途系基于公司募投项目开展的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司业务领域和方向，有利于公司长远发展，相关事项符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，我们审计委员会全体委员一致同意此议案，并提交董事会审议。

六、备查文件

（一）《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（二）《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会 2025 年第三次战略委员会会议决议》；

（三）《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会 2025 年第三次审计委员会会议决议》；

（四）《惠丰钻石股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议》；

（五）《中国银河证券股份有限公司关于惠丰钻石股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》。

惠丰钻石股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日